

证券代码：002916

证券简称：深南电路

深南电路股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-16

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（ <u>券商策略会</u> ）
活动参与人员（排名不分先后）	<p>国泰君安自营、招商证券自营、淳厚基金、广发资管、浩成资产、红土创新基金、创富兆业、源乘投资、红塔红土基金、平安证券、信达澳亚基金、Capstone Capital、三井住友德思资管、国任保险、玄甲私募、吉晟资产、东方阿尔法基金、华能贵诚信托、恒泰证券、Schroders、世纪证券、恒立基金、Grand Alliance Asset Management、纽富斯投资、财信证券、方正证券、景顺长城基金、Hel Ved Capital、Balyasny Asset Management（HK）、贝莱德、中环资产、橡树资本、博成基金、农银汇理、标朴投资、兆顺基金、国君资管、Pinpoint、中信保诚基金、兴业基金、华泰柏瑞基金、中信资管、重阳投资、鹏华基金、景林资产、前海人寿、诺安基金、江苏瑞华投资、昱奕资产、抱朴资管、国泰基金、远策投资、华夏基金、润晖投资、博裕资本、双安资产、国联证券自营、鹏扬基金、熵盈基金、正圆投资、Point72、德邦资管、易方达基金、人保养老、德邦基金、锦绣中和（天津）投资、中国银河证券、北京诚旻投资、北京暖逸欣私募基金、华创证券、建信养老金、中信里昂证券、申万宏源证券、摩根士丹利、东方证券、中信证券、财通证券、浙商证券、招商证券</p>
上市公司接待人员	<p>战略发展部总监、证券事务代表：谢丹；证券事务主管：阳佩琴； 投资者关系经理：郭家旭</p>
时间	<p>2025年5月8日</p>
地点	<p>申万宏源证券策略会、摩根士丹利策略会、东方证券策略会、中信证券策略会、财通证券策略会、浙商证券策略会、招商证券策略会</p>
形式	<p>实地调研</p>
投资者关系活动主要内容介绍	<p>交流主要内容：</p> <p>Q1、请介绍公司 2025 年第一季度经营业绩情况。</p> <p>2025 年第一季度，公司实现营业收入 47.83 亿元，同比增长 20.75%；归母净利润 4.91 亿元，同比增长 29.47%；扣非归母净利润 4.85 亿元，同比增长 44.64%。以上增长主要得益于高速网络通信、算力及服务器相关需求增长，以及汽车电动化/智能化趋势持续深化等市场机遇，公司实现 PCB 业务营收规模增长、产品结构优化，推动利润稳健增长。</p>

Q2、请介绍公司 2025 年第一季度 PCB 业务各下游领域经营拓展情况。

公司在 PCB 业务产品下游应用以通信设备为核心（覆盖无线侧及有线侧通信），重点布局数据中心（含服务器）、汽车电子（聚焦新能源和 ADAS 方向）等领域，并长期深耕工控、医疗等领域。2025 年第一季度，公司 PCB 业务通信领域无线侧订单较去年第四季度小幅度回升，有线侧交换机等需求保持增长。数据中心领域订单环比继续增长，主要得益于 AI 加速卡、服务器等产品需求增长。汽车电子继续把握在新能源和 ADAS 方向的机会，需求平稳增长。

Q3、请介绍公司 2025 年第一季度封装基板业务经营拓展情况。

公司封装基板产品覆盖种类广泛多样，包括模组类封装基板、存储类封装基板、应用处理器芯片封装基板等，主要应用于移动智能终端、服务器/存储等领域。具备了包括 WB、FC 封装形式全覆盖的封装基板技术能力。2025 年第一季度，公司封装基板业务需求较去年第四季度有一定改善，主要得益于存储类产品需求提升。

Q4、请介绍公司近期经营情况及工厂产能利用率情况。

公司近期各项业务经营正常，综合产能利用率仍处于相对高位，其中 PCB 业务因目前算力及汽车电子市场需求延续，近期工厂产能利用率保持高位运行；封装基板业务因近期存储领域需求相对改善，工厂产能利用率较 2024 年第四季度有所提升。

Q5、请介绍公司对美国销售收入的规模，美国关税政策对公司经营可能产生的影响。

2024 年及 2025 年第一季度，公司对美国直接销售收入占公司营业收入比重较低，公司整体受影响的范围较小。由于相关事项仍在动态演变中，产业链相关各方尚需时间对当前国际经贸环境发生的新变化进行研判并采取行动。公司正保持密切关注，并与产业链各相关方持续进行沟通，共同协商解决方案，做好灵活应对。

Q6、请介绍公司是否具备 HDI 工艺能力。

HDI 作为一项平台型工艺技术，可实现 PCB 板件的高密度布线。公司 PCB 业务具备 HDI 工艺能力，主要应用于通信、数据中心、工控医疗、汽车电子等下游领域的部分中高端产品。

Q7、请介绍公司 FC-BGA 封装基板产品技术能力及广州封装基板项目爬坡进展。

公司 FC-BGA 封装基板现已具备 20 层及以下产品批量生产能力，各阶产品相关送样认证工作有序进行。20 层以上产品的技术研发及打样工作按期推进中。

公司广州封装基板项目一期已于 2023 年第四季度连线，产品线能力持续提升，产能爬坡稳步推进，已承接 BT 类及部分 FC-BGA 产品的批量订单，但总体尚处于产能爬坡早期阶段，由此带来的成本及费用增加，对公司利润造成一定负向影响。得益于各类订单逐步投入生产，广州封装基板项目在本报告期内亏损环比已有所收窄。

Q8、请介绍公司 PCB 业务近年来扩产规划。

公司 PCB 业务在深圳、无锡、南通及泰国项目（在建）均设有工厂。一方面，公司通过对现有成熟 PCB 工厂进行技术改造和升级，打开瓶颈，提升产能；另一方面，公司有序推进南通四期项目建设，构建 HDI 工艺技术平台和产能，目前正在推进项目基础工程建设。公司将结合自身经营规划与市场需求情况，合理配置业务产能。

Q9、请介绍公司泰国工厂投资规模及业务定位。

公司在泰国工厂总投资额为 12.74 亿元人民币/等值外币。目前基础工程建设按期有序推进中，具体投产时间将根据后续建设进度、市场情况等因素确定。泰国工厂将具备高多层、HDI 等 PCB 工艺技术能力，其建设有利于公司进一步开拓海外市场，满足国际客户需求，完善产品在全球市场的供应能力。

Q10、请介绍原材料价格变化情况及对公司的影响。

公司主要原材料包括覆铜板、半固化片、铜箔、金盐、油墨等，涉及品类较多。2025 年一季度，受大宗商品价格变化影响，金盐等部分原材料价格同比提升、较 2024 年第四季度亦出现一定涨幅。公司将持续关注国际市场大宗商品价格变化以及上游原材料价格传导情况，并与供应商及客户保持积极沟通。

Q11、请介绍公司 PCB 业务在 PTFE 方面的布局情况。

PTFE 材料在高频 PCB 领域已有比较成熟的应用，公司在通信、汽车 ADAS 等高频应

	用场景已有相关成熟 PCB 产品。行业对 PTFE 在高速 PCB 领域的开发和大批量应用尚处在早期阶段，公司对行业前沿技术及应用保持关注与研究，已具有相应技术储备。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	调研过程中公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。
附件清单	无